

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

10.07.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2003年 1月 7日

REC'D 29 AUG 2003

出願番号  
Application Number: 特願 2003-001077

WIPO PCT

[ST. 10/C]: [JP 2003-001077]

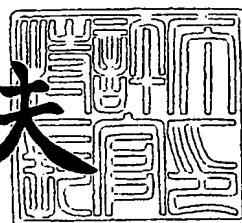
出願人  
Applicant(s): セイコーエプソン株式会社

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

2003年 8月 15日

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 J0095338

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/045

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 八十島 健

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100101236

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 浩之

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-227840

【出願日】 平成14年 8月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 042309

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0216673

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧力発生素子とを具備する液体噴射ヘッドにおいて、

少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に酸化タンタルからなる耐液体性の保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 2】 請求項 1において、前記保護膜の pH 8.5 以上の液体によるエッチングレートが 0.05 nm/day 以下であることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2において、前記保護膜がイオンアシスト蒸着によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 4】 請求項 1 又は 2において、前記保護膜が対向ターゲット式スパッタ法によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 5】 請求項 1 又は 2において、前記保護膜がプラズマ CVD 法によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 6】 請求項 1～5 の何れかにおいて、前記流路形成基板には、前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路が設けられており、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 7】 請求項 1～6 の何れかにおいて、前記圧力発生素子が前記圧力発生室の一方に設けられた振動板上に配設された圧電素子であることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 8】 請求項 7において、前記圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッチングにより形成され、前記圧電素子の各層が成膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 9】 請求項 1～8 の何れかの液体噴射ヘッドを具備することを特徴とする液体噴射装置。

【請求項 10】 シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、該流路形成基板の一方側に振動板を介して設けられて前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧電素子とを具備する液体噴射ヘッドの製造方法において、

少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に 150℃以下の温度条件で金属材料からなる耐液体性の保護膜を形成する工程を有することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 11】 請求項 10において、前記保護膜をイオンアシスト蒸着によって形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 12】 請求項 10において、前記保護膜を対向ターゲット式スパッタ法によって形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 13】 請求項 12において、前記保護膜を形成する際、対向するターゲットの表面の向きに対して前記圧力発生室の長手方向が直交するように前記流路形成基板を配置することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 14】 請求項 10において、前記保護膜をプラズマCVD法によって形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 15】 請求項 10～14の何れかにおいて、前記金属材料が、酸化タンタル又は酸化ジルコニウムであることを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 16】 請求項 10～15の何れかにおいて、前記流路形成基板に前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路を形成した後に、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜を形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

##### 【発明の属する技術分野】

本発明は、液滴を噴射するノズル開口と連通する圧力発生室に供給された液体を圧電素子の変形により加圧することによって、ノズル開口から液滴を噴射させる液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置に関する。

**【0002】****【従来の技術】**

液体噴射装置としては、例えば、圧電素子や発熱素子によりインク滴吐出のための圧力を発生させる複数の圧力発生室と、各圧力発生室にインクを供給する共通のリザーバと、各圧力発生室に連通するノズル開口とを備えたインクジェット式記録ヘッドを具備するインクジェット式記録装置があり、このインクジェット式記録装置では、印字信号に対応するノズルと連通した圧力発生室のインクに吐出エネルギーを印加してノズル開口からインク滴を吐出させる。

**【0003】**

このようなインクジェット式記録ヘッドには、前述したように圧力発生室として圧力発生室内に駆動信号によりジュール熱を発生する抵抗線等の発熱素子を設け、この発熱素子の発生するバブルによってノズル開口からインク滴を吐出させるものと、圧力発生室の一部を振動板で構成し、この振動板を圧電素子により変形させてノズル開口からインク滴を吐出させる圧電振動式の2種類のものに大別される。

**【0004】**

また、圧電振動式のインクジェット式記録ヘッドには、圧電素子の軸方向に伸長、収縮する縦振動モードの圧電アクチュエータを使用したものと、たわみ振動モードの圧電アクチュエータを使用したものの2種類が実用化されている。

**【0005】**

前者は圧電素子の端面を振動板に当接させることにより圧力発生室の容積を変化させることができて、高密度印刷に適したヘッドの製作が可能である反面、圧電素子をノズル開口の配列ピッチに一致させて櫛歯状に切り分けるという困難な工程や、切り分けられた圧電素子を圧力発生室に位置決めして固定する作業が必要となり、製造工程が複雑であるという問題がある。

**【0006】**

これに対して後者は、圧電材料のグリーンシートを圧力発生室の形状に合わせて貼付し、これを焼成するという比較的簡単な工程で振動板に圧電素子を作り付けることができるものの、たわみ振動を利用する関係上、ある程度の面積が必要

となり、高密度配列が困難であるという問題がある。

### 【0007】

一方、後者の記録ヘッドの不都合を解消すべく、振動板の表面全体に亘って成膜技術により均一な圧電材料層を形成し、この圧電材料層をリソグラフィ法により圧力発生室に対応する形状に切り分けて各圧力発生室毎に独立するように圧電素子を形成したものが提案されている（例えば、引用文献1参照）。

### 【0008】

これによれば圧電素子を振動板に貼付ける作業が不要となって、リソグラフィ法という精密で、かつ簡便な手法で圧電素子を高密度に作り付けることができるばかりでなく、圧電素子の厚みを薄くできて高速駆動が可能になるという利点がある。

### 【0009】

このような従来のインクジェット式記録ヘッドは、一般的に、インクキャビティ（圧力発生室）がシリコン基板に形成され、インクキャビティの一方面を構成する振動板はシリコン酸化膜で形成されている。このため、アルカリ性のインクを用いると、インクによってシリコン基板が除々に溶解されて各圧力発生室の幅が経時的に変化してしまう。そして、このことが、圧電素子の駆動によって圧力発生室内に付与される圧力を変化させる原因となり、インク吐出特性が除々に低下してしまうという問題がある。このため、インクキャビティ内に親水性及び耐アルカリ性を備えた膜、例えば、ニッケル膜等を設け、インクによるシリコン基板等の溶解を防止したものがある（例えば、特許文献2参照）。

### 【0010】

#### 【特許文献1】

特開平5-286131号公報（第3図、【0013】）

#### 【特許文献2】

特開平10-264383号公報（第1図、【0020】）

### 【0011】

#### 【発明が解決しようとする課題】

このようにインクキャビティ内にニッケル膜等を設けることによりインクによ

る溶解をある程度防止することはできる。しかしながら、ニッケル膜等もインクによって徐々に溶解されてしまうため、長期間使用するとインク吐出特性が低下してしまうという問題がある。特に、比較的高いpHのインクを用いた場合には、溶解速度が高まるため、インク吐出特性も比較的短期間で低下してしまう。なお、このような問題は、インクを吐出するインクジェット式記録ヘッドだけでなく、勿論、インク以外のアルカリ性の液体を噴射する他の液体噴射ヘッドにおいても、同様に存在する。

#### 【0012】

本発明は、このような事情に鑑み、液体吐出特性を長期間一定に維持することができ且つノズル詰まりを防止した液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置を提供することを課題とする。

#### 【0013】

##### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決する本発明の第1の態様は、シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧力発生素子とを具備する液体噴射ヘッドにおいて、少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に酸化タンタルからなる耐液体性の保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0014】

かかる第1の態様では、液体に対して非常に優れた耐エッチング性を有する保護膜を形成でき、流路形成基板が液体に溶解されるのを確実に防止することができる。したがって、各圧力発生室を製品製造時と略同一形状に維持することができ、液体吐出特性を長期間一定に維持することができる。また、ノズル詰まりを防止することもできる。

#### 【0015】

本発明の第2の態様は、第1の態様において、前記保護膜のpH 8.5以上の液体によるエッティングレートが0.05 nm/day以下であることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0016】

かかる第2の態様では、保護膜がpH 8.5以上の比較的大きなpHの液体、すなわち、アルカリ性の液体に対して優れた耐エッティング性を有しているため、各圧力発生室を製品製造時と略同一形状に更に長期間維持することができる。

#### 【0017】

本発明の第3の態様は、第1又は2の態様において、前記保護膜がイオンアシスト蒸着によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0018】

かかる第3の態様では、緻密な保護膜を比較的容易且つ確実に形成することができる。

#### 【0019】

本発明の第4の態様は、第1又は2の態様において、前記保護膜が対向ターゲット式スパッタ法によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0020】

かかる第4の態様では、緻密な保護膜を比較的容易且つ確実に形成することができる。

#### 【0021】

本発明の第5の態様は、第1又は2の態様において、前記保護膜がプラズマCVD法によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0022】

かかる第5の態様では、緻密な保護膜を比較的容易且つ確実に形成することができる。

#### 【0023】

本発明の第6の態様は、第1～5の何れかの態様において、前記流路形成基板には、前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路が設けられており、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0024】

かかる第6の態様では、液体流路の内壁表面が液体に溶解されるのを保護膜に

よって確実に防止できるため、液体流路の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができる。したがって、各圧力発生室に液体を良好に供給することができる。

#### 【0025】

本発明の第7の態様では、第1～6の何れかの態様において、前記圧力発生素子が前記圧力発生室の一方に設けられた振動板上に配設された圧電素子であることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0026】

かかる第7の態様では、圧電素子が撓み変位することにより振動板を介して圧力発生室内に圧力変化が生じ、ノズル開口から液滴が吐出される。

#### 【0027】

本発明の第8の態様は、第7の態様において、前記圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッティングにより形成され、前記圧電素子の各層が成膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0028】

かかる第8の態様では、高密度のノズル開口を有する液体噴射ヘッドを大量に且つ比較的容易に製造することができる。

#### 【0029】

本発明の第9の態様は、第1～8の何れかの態様の液体噴射ヘッドを具備することを特徴とする液体噴射装置にある。

#### 【0030】

かかる第9の態様では、液体吐出特性が実質的に安定し且つ信頼性を向上した液体噴射装置を実現することができる。

#### 【0031】

本発明の第10の態様は、シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、該流路形成基板の一方側に振動板を介して設けられて前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧電素子とを具備する液体噴射ヘッドの製造方法において、少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に

150℃以下の温度条件で金属材料からなる耐液体性の保護膜を形成する工程を有することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

#### 【0032】

かかる第10の態様では、比較的低い温度条件、例えば、150℃以下で保護膜を形成することができるため、例えば、圧電素子等が破壊されるのを確実に防止することができる。

#### 【0033】

本発明の第11の態様は、第10の態様において、前記保護膜をイオンアシスト蒸着によって形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

#### 【0034】

かかる第11の態様では、比較的低い温度条件下で保護膜を形成することができる。

#### 【0035】

本発明の第12の態様は、第10の態様において、前記保護膜を対向ターゲット式スパッタ法によって形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

#### 【0036】

かかる第12の態様では、各圧力発生室等の内面に、緻密な膜が略均一な厚さで形成される。また、成膜レートが速いため、製造効率が向上する。

#### 【0037】

本発明の第13の態様は、第12の態様において、前記保護膜を形成する際、対向するターゲットの表面の向きに対して前記圧力発生室の長手方向が直交するよう前記流路形成基板を配置することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

#### 【0038】

かかる第13の態様では、圧力発生室等の内面全面に、保護膜を比較的容易且つ良好に形成することができる。

#### 【0039】

本発明の第14の態様は、第10の態様において、前記保護膜をプラズマCV

D法によって形成することを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

#### 【0040】

かかる第14の態様では、圧力発生室等の内面全面に亘って連続する保護膜を、比較的容易且つ良好に形成することができる。

#### 【0041】

本発明の第15の態様は、第10～14の何れかの態様において、前記金属材料が、酸化タンタル又は酸化ジルコニウムであることを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

#### 【0042】

かかる第15の態様では、比較的低い温度条件下での膜形成が可能であり且つ液体に対して非常に優れた耐エッチング性を有する保護膜を形成できる。特に、酸化タンタルによって形成された保護膜は、比較的大きなpH、例えば、pH8.5以上の液体に対して特に優れた耐エッチング性を発揮する。これにより、各圧力発生室を製品製造時と略同一形状に長期間維持することができる。

#### 【0043】

本発明の第16の態様は、第10～15の何れかの態様において、前記流路形成基板に前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路を形成した後に、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜を形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

#### 【0044】

かかる第16の態様では、液体流路の内壁表面が液体に溶解されるのを保護膜によって確実に防止できるため、液体流路の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができる。したがって、各圧力発生室に液体を良好に供給することができる。

#### 【0045】

##### 【発明の実施の形態】

以下に本発明を実施形態に基づいて詳細に説明する。

##### (実施形態1)

図1は、本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドの概略を示す

分解斜視図であり、図2は、図1の平面図及び断面図である。図示するように、流路形成基板10は、本実施形態では面方位(110)のシリコン単結晶基板からなり、その各表面には予め熱酸化により形成した二酸化シリコンからなる、厚さ1～2μmの弹性膜50及び絶縁膜55がそれぞれ形成されている。この流路形成基板10には、シリコン単結晶基板をその一方側から異方性エッティングすることにより、複数の隔壁11によって区画された圧力発生室12が幅方向に並設されている。また、その長手方向外側には、後述する封止基板30のリザーバ部32と連通される連通部13が形成されている。また、この連通部13は、各圧力発生室12の長手方向一端部でそれぞれインク供給路14を介して連通されている。

#### 【0046】

ここで、異方性エッティングは、シリコン単結晶基板のエッティングレートの違いを利用して行われる。例えば、本実施形態では、シリコン単結晶基板をKOH等のアルカリ溶液に浸漬すると、徐々に侵食されて(110)面に垂直な第1の(111)面と、この第1の(111)面と約70度の角度をなし且つ上記(110)面と約35度の角度をなす第2の(111)面とが出現し、(110)面のエッティングレートと比較して(111)面のエッティングレートが約1/180であるという性質を利用して行われる。かかる異方性エッティングにより、二つの第1の(111)面と斜めの二つの第2の(111)面とで形成される平行四辺形状の深さ加工を基本として精密加工を行うことができ、圧力発生室12を高密度に配列することができる。本実施形態では、各圧力発生室12の長辺を第1の(111)面で、短辺を第2の(111)面で形成している。この圧力発生室12は、流路形成基板10をほぼ貫通して弹性膜50に達するまでエッティングすることにより形成されている。ここで、弹性膜50は、シリコン単結晶基板をエッティングするアルカリ溶液に侵される量がきわめて小さい。また、各圧力発生室12の一端に連通する各インク供給路14は、圧力発生室12より浅く形成されており、圧力発生室12に流入するインクの流路抵抗を一定に保持している。すなわち、インク供給路14は、シリコン単結晶基板を厚さ方向に途中までエッティング(ハーフエッティング)することにより形成されている。なお、ハーフエッティング

は、エッティング時間の調整により行われる。

#### 【0047】

このような圧力発生室12等が形成される流路形成基板10の厚さは、圧力発生室12を配設する密度に合わせて最適な厚さを選択することが好ましい。例えば、1インチ当たり180個（180 d p i）程度に圧力発生室12を配置する場合には、流路形成基板10の厚さは、180～280  $\mu$ m程度、より望ましくは、220  $\mu$ m程度とするのが好適である。また、例えば、360 d p i程度と比較的高密度に圧力発生室12を配置する場合には、流路形成基板10の厚さは、100  $\mu$ m以下とするのが好ましい。これは、隣接する圧力発生室12間の隔壁11の剛性を保ちつつ、配列密度を高くできるからである。

#### 【0048】

また、流路形成基板10の開口面側には、各圧力発生室12のインク供給路14とは反対側で連通するノズル開口21が穿設されたノズルプレート20が接着剤や熱溶着フィルム等を介して固着されて圧力発生室12等が封止されている。なお、このノズルプレート20は、本実施形態では、ステンレス鋼（SUS）で形成されている。

#### 【0049】

ここで、流路形成基板10の少なくとも圧力発生室12の内壁表面には、酸化タンタルからなり耐インク性を有する保護膜100が設けられている。例えば、本実施形態では、五酸化タンタル（Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）からなる保護膜100が、流路形成基板10のインクに接触する全ての表面に設けられている。具体的には、圧力発生室12の隔壁11及び弾性膜50の表面に保護膜100が設けられると共に、各圧力発生室12に連通するインク供給路14及び連通部13のインク流路の内壁表面にも保護膜100が設けられている。また、このような保護膜100の厚さは、特に限定されないが、本実施形態では、各圧力発生室12の大きさ及び振動板の変位量等を考慮して50 nm程度とした。

#### 【0050】

このような酸化タンタルからなる保護膜100は、インクに対して非常に優れた耐エッティング性（耐インク性）を有し、特に、アルカリ性のインクに対する耐

エッティング性を有する。具体的には、pH 8.5 以上のインクによるエッティングレートが 25°C、0.05 nm/day 以下である。このように、酸化タンタルからなる保護膜 100 は、比較的アルカリ性が強いインクに対して非常に優れた耐エッティング性を有しているため、インクジェット式記録ヘッド用のインクに対しては特に有効である。例えば、本実施形態の五酸化タンタルからなる保護膜 100 は、pH 9.1 のインクによるエッティングレートが 25°C で、0.03 nm/day であった。

#### 【0051】

このように、流路形成基板 10 の圧力発生室 12 等が開口する側の表面に五酸化タンタルからなる保護膜 100 を設けることにより、インク吐出特性を長期間に亘って一定に維持することができる。具体的には、圧力発生室 12 の内壁表面に保護膜 100 を設けるようにしたので、流路形成基板 10 及び振動板がインクに溶解されることを防止することができる。これにより、圧力発生室 12 の形状を実質的に安定させる、すなわち、製品製造時と略同一形状に維持することができる。また、各圧力発生室 12 の内壁表面以外のインク供給路 14 及び連通部 13 のインク流路の内壁表面にも保護膜 100 を設けるようにしたので、圧力発生室 12 と同様の理由からインク流路の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができる。これらのことから、インク吐出特性を長期間一定に維持することができる。さらに、流路形成基板 10 がインクに溶解されるのを保護膜 100 によって防止することができるため、インクに溶解された流路形成基板 10 の溶解物がインク中に析出する量が実質的に低減され、ノズル詰まりの発生を防止することができる。これにより、ノズル開口 21 からインク滴を良好に吐出させることができる。

#### 【0052】

なお、このような保護膜 100 の材料としては、使用するインクの pH 値によっては、例えば、酸化ジルコニウム (ZrO<sub>2</sub>)、ニッケル (Ni) 及びクロム (Cr) 等を用いることもできるが、酸化タンタルを用いることにより、pH 値の高いインクを使用する場合でも、極めて優れた耐エッティング性を発揮する。

#### 【0053】

また、本実施形態では、流路形成基板10の圧力発生室12等が開口する側の表面にも保護膜100が形成され、この保護膜100を介して流路形成基板10とノズルプレート20とが接合されているため、両者の接着強度が向上するという効果も得られる。勿論、ノズルプレート20との接合面にはインクは実質的に接触しないため、保護膜100は設けられていてもよい。

#### 【0054】

一方、このような流路形成基板10の開口面とは反対側の弾性膜50の上には、厚さが例えば、約0.2μmの下電極膜60と、厚さが例えば、約1μmの圧電体層70と、厚さが例えば、約0.1μmの上電極膜80とが、後述するプロセスで積層形成されて、圧電素子300を構成している。ここで、圧電素子300は、下電極膜60、圧電体層70、及び上電極膜80を含む部分をいう。一般的には、圧電素子300の何れか一方の電極を共通電極とし、他方の電極及び圧電体層70を各圧力発生室12毎にパターニングして構成する。そして、ここではパターニングされた何れか一方の電極及び圧電体層70から構成され、両電極への電圧の印加により圧電歪みが生じる部分を圧電体能動部という。本実施形態では、下電極膜60は圧電素子300の共通電極とし、上電極膜80を圧電素子300の個別電極としているが、駆動回路や配線の都合でこれを逆にしても支障はない。何れの場合においても、各圧力発生室毎に圧電体能動部が形成されることになる。また、ここでは、圧電素子300と当該圧電素子300の駆動により変位が生じる振動板とを合わせて圧電アクチュエータと称する。また、このような各圧電素子300の上電極膜80には、例えば、金(Au)等からなるリード電極90がそれぞれ接続されている。このリード電極90は、各圧電素子300の長手方向端部近傍から引き出され、インク供給路14に対応する領域の弾性膜50上までそれぞれ延設されている。

#### 【0055】

この流路形成基板10の圧電素子300側には、圧電素子300の運動を阻害しない程度の空間を確保した状態で、その空間を密封可能な圧電素子保持部31を有する封止基板30が接合され、圧電素子300はこの圧電素子保持部31内に密封されている。さらに、封止基板30には、連通部13に対応する領域に封

止基板30を貫通するリザーバ部32が設けられ、このリザーバ部32は、上述のように流路形成基板10の連通部13と連通されて各圧力発生室12の共通のインク室となるリザーバ110を構成している。このような封止基板30は、流路形成基板10の熱膨張率と略同一の材料、例えば、ガラス、セラミック材料等で形成されていることが好ましく、本実施形態では、流路形成基板10と同一材料のシリコン単結晶基板を用いて形成した。

#### 【0056】

なお、封止基板30の圧電素子保持部31とリザーバ部32との間、すなわちインク供給路14に対応する領域には、この封止基板30を厚さ方向に貫通する貫通孔33が設けられている。そして、各圧電素子300から引き出されたリード電極90は、この貫通孔33まで延設されており、ワイヤボンディング等により図示しない駆動ICと接続される。

#### 【0057】

また、このような封止基板30上には、封止膜41及び固定板42からなるコンプライアンス基板40が接合されている。封止膜41は、剛性が低く可撓性を有する材料（例えば、厚さが6μmのポリフェニレンサルファイド（PPS）フィルム）からなり、この封止膜41によってリザーバ部32の一方が封止されている。また、固定板42は、金属等の硬質の材料（例えば、厚さが30μmのステンレス鋼（SUS）等）で形成される。この固定板42のリザーバ110に対向する領域は、厚さ方向に完全に除去された開口部43となっているため、リザーバ110の一方は可撓性を有する封止膜41のみで封止されている。

#### 【0058】

このような本実施形態のインクジェット式記録ヘッドは、図示しない外部インク供給手段からインクを取り込み、リザーバ110からノズル開口21に至るまで内部をインクで満たした後、図示しない駆動回路からの記録信号に従い、外部配線を介して圧力発生室12に対応するそれぞれの下電極膜60と上電極膜80との間に電圧を印加し、弾性膜50、下電極膜60及び圧電体層70をたわみ変形させることにより、各圧力発生室12内の圧力が高まりノズル開口21からインク滴が吐出する。

### 【0059】

以下、このような本実施形態のインクジェット式記録ヘッドの製造方法、特に、流路形成基板10上に圧電素子300を形成するプロセス及び流路形成基板10に圧力発生室12等を形成するプロセスについて、図3～図5を参照して説明する。なお、図3～図5は、圧力発生室12の長手方向の断面図である。

### 【0060】

まず、図3 (a) に示すように、流路形成基板10となるシリコン単結晶基板のウェハを約1100℃の拡散炉で熱酸化して弾性膜50及び絶縁膜55を構成する二酸化シリコン膜51を全面に形成する。次いで、図3 (b) に示すように、弾性膜50となる二酸化シリコン膜51上にスパッタリングで下電極膜60を形成すると共に、所定形状にパターニングする。このような下電極膜60の材料としては、白金(Pt)等が好適である。これは、スパッタリング法やゾルーゲル法で成膜する後述の圧電体層70は、成膜後に大気雰囲気下又は酸素雰囲気下で600～1000℃程度の温度で焼成して結晶化させる必要があるからである。すなわち、下電極膜60の材料は、このような高温、酸化雰囲気下で導電性を保持できなければならず、殊に、圧電体層70としてチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)を用いた場合には、酸化鉛の拡散による導電性の変化が少ないことが望ましく、これらの理由から白金が好適である。

### 【0061】

次に、図3 (c) に示すように、圧電体層70を成膜する。この圧電体層70は、結晶が配向していることが好ましい。例えば、本実施形態では、金属有機物を触媒に溶解・分散したいわゆるゾルを塗布乾燥してゲル化し、さらに高温で焼成することで金属酸化物からなる圧電体層70を得る、いわゆるゾルーゲル法を用いて形成することにより、結晶が配向している圧電体層70とした。圧電体層70の材料としては、チタン酸ジルコン酸鉛系の材料がインクジェット式記録ヘッドに使用する場合には好適である。なお、この圧電体層70の成膜方法は、特に限定されず、例えば、スパッタリング法で形成してもよい。さらに、ゾルーゲル法又はスパッタリング法等によりチタン酸ジルコン酸鉛の前駆体膜を形成後、アルカリ水溶液中の高圧処理法にて低温で結晶成長させる方法を用いてもよい。

。何れにしても、このように成膜された圧電体層70は、バルクの圧電体とは異なり結晶が優先配向しており、且つ本実施形態では、圧電体層70は、結晶が柱状に形成されている。なお、優先配向とは、結晶の配向方向が無秩序ではなく、特定の結晶面がほぼ一定の方向に向いている状態をいう。また、結晶が柱状の薄膜とは、略円柱体の結晶が中心軸を厚さ方向に略一致させた状態で面方向に亘って集合して薄膜を形成している状態をいう。勿論、優先配向した粒状の結晶で形成された薄膜であってもよい。なお、このように薄膜工程で製造された圧電体層の厚さは、一般的に0.2～5μmである。

#### 【0062】

次に、図3 (d) に示すように、上電極膜80を成膜する。上電極膜80は、導電性の高い材料であればよく、アルミニウム、金、ニッケル、白金等の多くの金属や、導電性酸化物等を使用できる。本実施形態では、白金をスパッタリングにより成膜している。次に、図3 (e) に示すように、圧電体層70及び上電極膜80のみをエッチングして圧電素子300のパターニングを行う。次いで、図4 (a) に示すように、リード電極90を形成する。具体的には、例えば、金(Au)等からなるリード電極90を流路形成基板10の全面に亘って形成すると共に、各圧電素子300毎にパターニングする。以上が膜形成プロセスである。

#### 【0063】

このようにして膜形成を行った後、前述したアルカリ溶液によるシリコン単結晶基板(流路形成基板10)の異方性エッチングを行い、圧力発生室12、連通部13及びインク供給路14を形成する。具体的には、まず、図4 (b) に示すように、流路形成基板10の圧電素子300側に、圧電素子保持部31、リザーバ部32及び接続孔33等が予め形成された封止基板30を接合する。

#### 【0064】

次に、図4 (c) に示すように、流路形成基板10の表面上に形成されている絶縁膜55(二酸化シリコン膜51)を所定形状にパターニングする。次いで、図5 (a) に示すように、この絶縁膜55を介して、前述したアルカリ溶液による異方性エッチングを行うことにより、流路形成基板10に圧力発生室12、連通部13及びインク供給路14等を形成する。なお、このように絶縁膜55をパ

ターニングする際、及び流路形成基板10の異方性エッチングを行う際には、封止基板30の表面を封止した状態で行う。

#### 【0065】

その後、図5（b）に示すように、流路形成基板10の圧力発生室12、連通部13及びインク供給路14の内壁表面上に、150°C以下、より好ましくは100°C以下の温度条件下で保護膜100を形成する。例えば、本実施形態では、イオンアシスト蒸着によって100°C以下の温度条件下で五酸化タンタル（Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）からなる保護膜100を形成した。なお、このとき、流路形成基板10の各圧力発生室12等が開口する側の面、すなわち、絶縁膜55の表面にも保護膜100が形成される。

#### 【0066】

このように150°C以下の温度条件、本実施形態では、100°C以下の温度条件下で保護膜100を形成するようにしたので、熱によって圧電素子300等に悪影響を及ぼすことなく、保護膜100を比較的容易且つ良好に形成することができる。また、150°C以下の温度条件では、圧電素子保持部31等の密封された空間が破壊される心配もなく、水分等が圧電素子保持部31内に侵入して圧電素子300が破壊されることもない。

#### 【0067】

また、保護膜100の材料として、五酸化タンタルを用いることにより、非常に優れた耐エッチング性を有する保護膜100とすることができます。したがって、流路形成基板10がインクに溶解されることはなく、インク吐出特性を長期間に亘って一定に維持することができる。

#### 【0068】

なお、このように保護膜100を形成した後は、連通部13に対向する領域の弹性膜50等を除去して連通部13とリザーバ部32とを連通させる。そして、流路形成基板10の封止基板30とは反対側の面にノズル開口21が穿設されたノズルプレート20を接合すると共に、封止基板30にコンプライアンス基板40を接合して本実施形態のインクジェット式記録ヘッドとする。また、実際には、上述した一連の膜形成及び異方性エッチングによって一枚のウェハ上に多数の

チップを同時に形成し、プロセス終了後、図1に示すような一つのチップサイズの流路形成基板10毎に分割する。

#### 【0069】

また、本実施形態では、イオンアシスト蒸着法により保護膜100を形成するようにしたが、保護膜を形成する方法はこれに限定されず、例えば、対向ターゲット式スパッタ法により保護膜100を形成するようにしてもよい。このように対向ターゲット式スパッタ法を用いても、イオンアシスト蒸着と同様に100℃以下の温度条件で緻密な保護膜を良好に形成することができる。また、成膜レートが非常に速いため、製造効率が向上し製造コストの低減を図ることもできる。さらに、保護膜100を形成する際にチャンバ内の圧力を比較的低くすることにより緻密な保護膜とすることができます。

#### 【0070】

また、対向ターゲット式スパッタ法によって保護膜100を形成する場合、図6に示すように、圧力発生室12の長手方向がターゲット200の面の方向（図中上下方向）に対して約90°となるように、流路形成基板10となるウェハ210を配置することが好ましい。これにより、ウェハ210を固定した状態であっても、ターゲット200から放出された原子は、各圧力発生室12等の内面に確実に付着する。すなわち、ターゲット200から放出された原子は、圧力発生室12の長手方向に沿って移動するため、各圧力発生室12の底面まで比較的均等に入り込む。したがって、各圧力発生室12等の内面に保護膜100を均一な厚さで形成することができる。勿論、ウェハ210を面方向で回転させながら保護膜100を形成するようにしてもよいことは言うまでもない。

#### 【0071】

なお、図7に示すように、圧力発生室12の長手方向がターゲット200の面の方向に対して平行となるように、ウェハ210を配置して保護膜100を形成した場合、ターゲット200から放出された原子は、圧力発生室12の幅方向に沿って移動するため、圧力発生室12の位置によって原子が入り込む深さ等に偏りが生じてしまう。このため、圧力発生室12等の内面全面に亘って保護膜100が形成されない虞や、保護膜100の厚さにばらつきが生じる虞がある。

**【0072】**

また、イオンアシスト蒸着法の代わりに、プラズマCVD（化学的気相成長）法によって保護膜100を形成するようにしてもよい。この方法によっても、150℃以下の温度条件で緻密な膜を形成することができる。特に、プラズマCVD法によって保護膜100を形成する場合、所定の条件を選択することで、図8に示すように、圧力発生室12の側面と底面とで形成される角部12aや、圧力発生室12の開口周縁部12b等にも保護膜100を良好に形成することができる。したがって、耐久性及び信頼性を著しく向上したインクジェット式記録ヘッドを実現することができる。

**【0073】**

なお、これらイオンアシスト蒸着、対向ターゲット式スパッタ法、プラズマCVD法等の他に、例えば、ECR（電子サイクロトロン共鳴）スパッタ法等の他の物理的気相成長法（PVD）等によっても、比較的低温で緻密な保護膜を形成することができる。

**【0074】****(他の実施形態)**

以上、本発明の各実施形態を説明したが、インクジェット式記録ヘッド及びその製造方法の基本的構成は上述したものに限定されるものではない。例えば、上述した実施形態では、各圧力発生室12、連通部13及びインク供給路14の内壁表面に耐インク性の保護膜100を設けるようにしたが、これに限定されず、少なくとも各圧力発生室の内壁表面に保護膜が設けられていればよい。このような構成としても、インク吐出特性を長期間一定に維持することができる。また、上述した実施形態では、ステンレス鋼からなるノズルプレート20を例示したが、シリコンからなるノズルプレートであってもよい。なお、この場合には、ノズルプレートがインクに溶解されてしまうため、ノズルプレートの各圧力発生室の少なくとも表面に保護膜を設けることが望ましい。

**【0075】**

また、上述の実施形態では、圧力発生素子として圧電素子を用いたたわみ振動型のインクジェット式記録ヘッドについて説明したが、勿論これに限定されず、

例えば、縦振動型のインクジェット式記録ヘッド、あるいは圧力発生室内に抵抗線を設けた電気熱変換式のインクジェット式記録ヘッド等、種々の構造のインクジェット式記録ヘッドに適用することができる。さらに、上述の実施形態では、成膜及びリソグラフィプロセスを応用して製造される薄膜型のインクジェット式記録ヘッドを例にしたが、勿論これに限定されるものではなく、例えば、グリーンシートを貼付する等の方法により形成される厚膜型のインクジェット式記録ヘッドにも本発明を採用することができる。

### 【0076】

また、このようなインクジェット式記録ヘッドは、インクカートリッジ等と連通するインク流路を具備する記録ヘッドユニットの一部を構成して、インクジェット式記録装置に搭載される。図9は、そのインクジェット式記録装置の一例を示す概略図である。図9に示すように、インクジェット式記録ヘッドを有する記録ヘッドユニット1A及び1Bは、インク供給手段を構成するカートリッジ2A及び2Bが着脱可能に設けられ、この記録ヘッドユニット1A及び1Bを搭載したキャリッジ3は、装置本体4に取り付けられたキャリッジ軸5に軸方向移動自在に設けられている。この記録ヘッドユニット1A及び1Bは、それぞれブラックインク組成物及びカラーインク組成物を吐出するものとしている。

### 【0077】

そして、駆動モータ6の駆動力が図示しない複数の歯車およびタイミングベルト7を介してキャリッジ3に伝達されることで、記録ヘッドユニット1A及び1Bを搭載したキャリッジ3はキャリッジ軸5に沿って移動される。一方、装置本体4にはキャリッジ軸5に沿ってプラテン8が設けられており、図示しない給紙ローラなどにより給紙された紙等の記録媒体である記録シートSがプラテン8上を搬送されるようになっている。

### 【0078】

なお、上述した実施形態においては、本発明の液体噴射ヘッドの一例としてインクジェット式記録ヘッドを説明したが、液体噴射ヘッドの基本的構成は上述したものに限定されるものではない。本発明は、広く液体噴射ヘッドの全般を対象としたものであり、インク以外のアルカリ性の液体を噴射するものにも勿論適用

することができる。その他の液体噴射ヘッドとしては、例えば、プリンタ等の画像記録装置に用いられる各種の記録ヘッド、液晶ディスプレー等のカラーフィルタの製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ELディスプレー、FED（面発光ディスプレー）等の電極形成に用いられる電極材料噴射ヘッド、バイオchip製造に用いられる生体有機物噴射ヘッド等が挙げられる。このように、アルカリ性の液体を噴射する液体噴射ヘッドに本発明を適用すれば、上述した実施形態と同じ優れた効果を得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 実施形態1に係る記録ヘッドの分解斜視図である。
- 【図2】 実施形態1に係る記録ヘッドの平面図及び断面図である。
- 【図3】 実施形態1に係る記録ヘッドの製造工程を示す断面図である。
- 【図4】 実施形態1に係る記録ヘッドの製造工程を示す断面図である。
- 【図5】 実施形態1に係る記録ヘッドの製造工程を示す断面図である。
- 【図6】 記録ヘッドの製造工程の他の例を示す概略図である。
- 【図7】 記録ヘッドの製造工程の他の例を説明するための概略図である。
- 【図8】 実施形態1に係る記録ヘッドの他の例を示す断面図である。
- 【図9】 一実施形態に係る記録装置の概略図である。

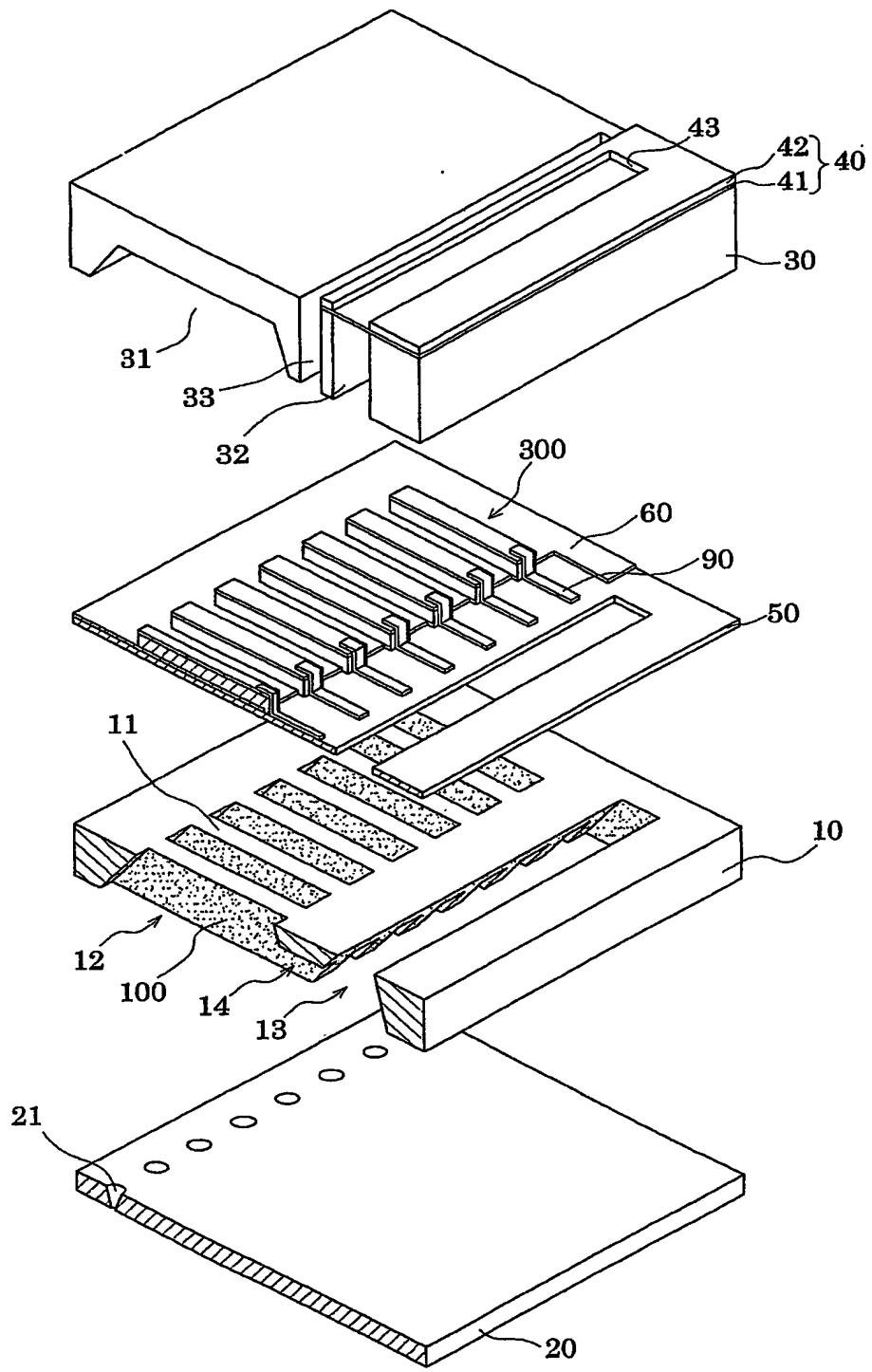
#### 【符号の説明】

10 流路形成基板、 12 圧力発生室、 13 連通部、 14 インク供給路、 20 ノズルプレート、 21 ノズル開口、 30 封止基板、  
31 圧電素子保持部、 32 リザーバ部、 40 コンプライアンス基板、  
50 弾性膜、 60 下電極膜、 70 圧電体層、 80 上電極膜、  
100 保護膜、 110 リザーバ、 200 ターゲット、 300 圧電素子

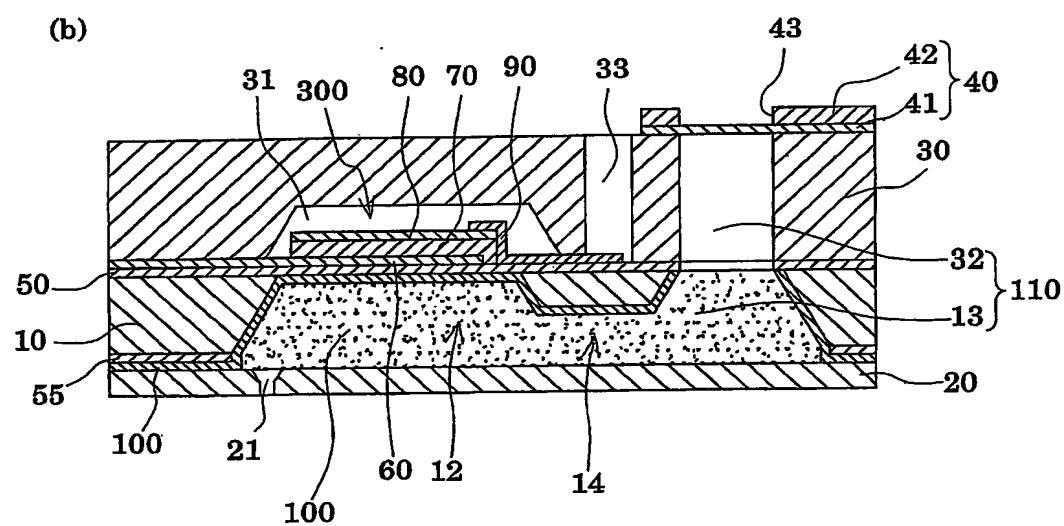
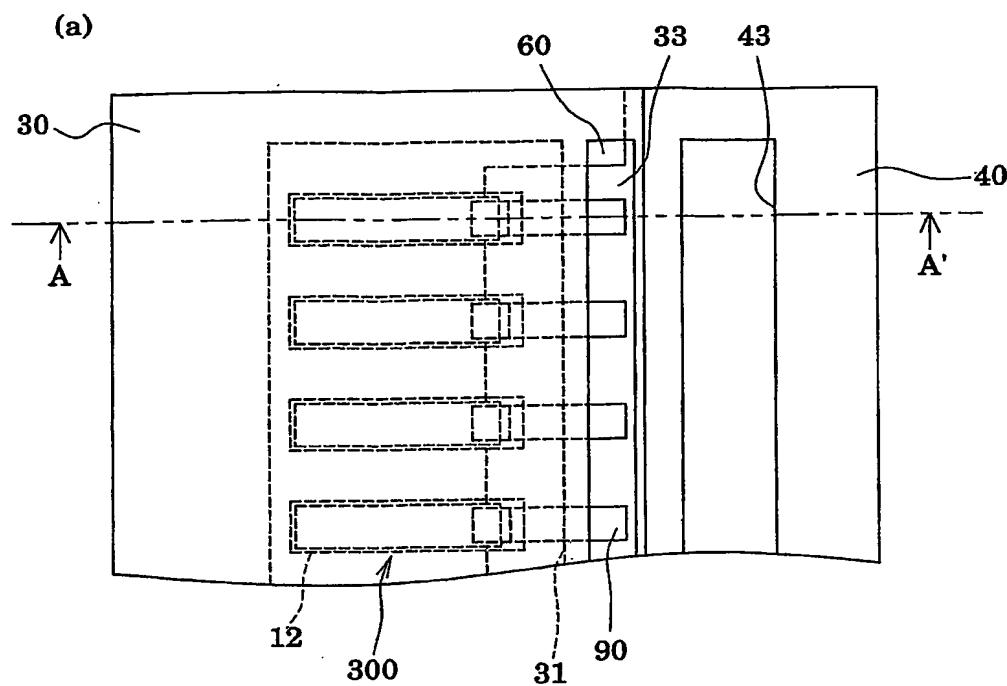
【書類名】

図面

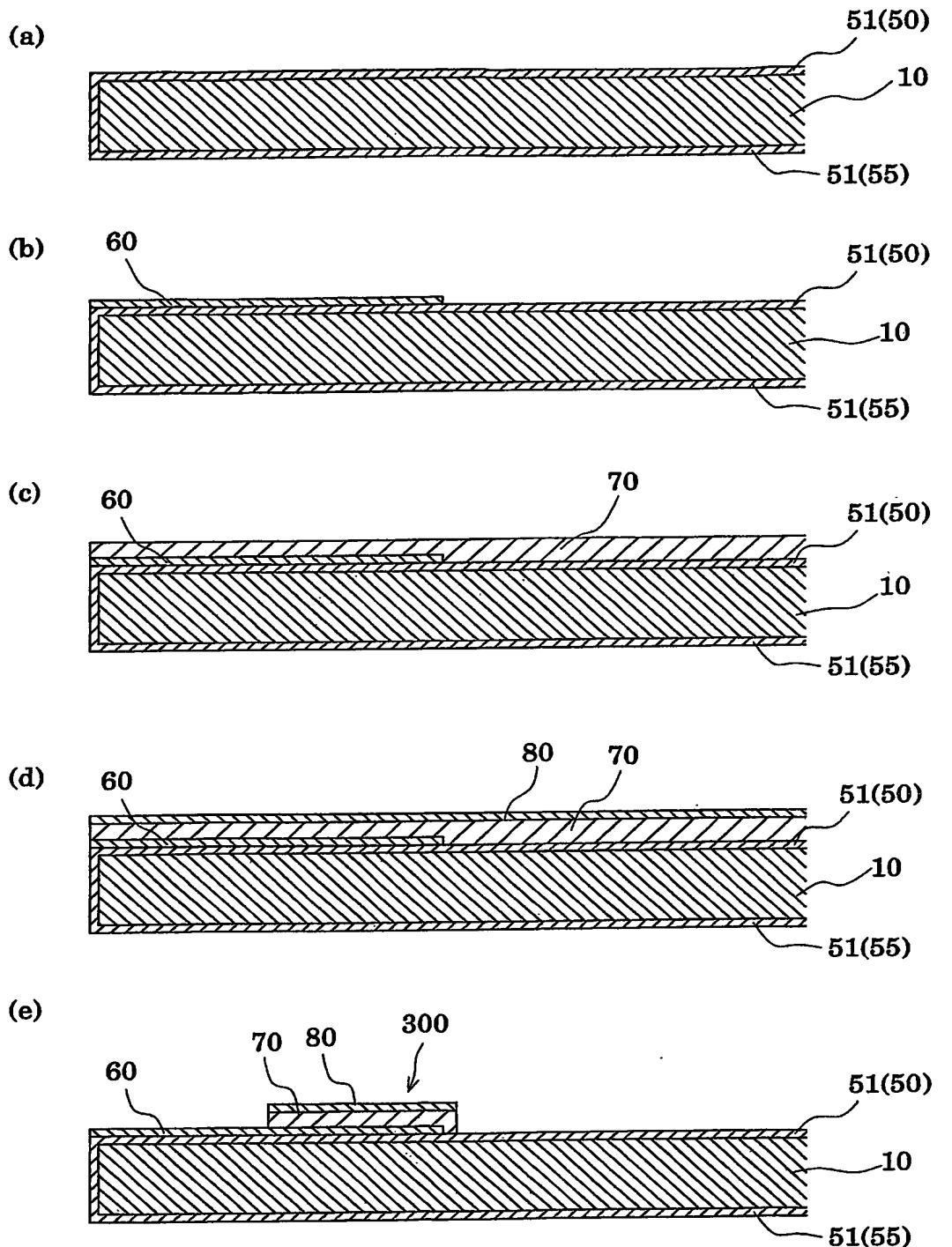
【図 1】



【図2】

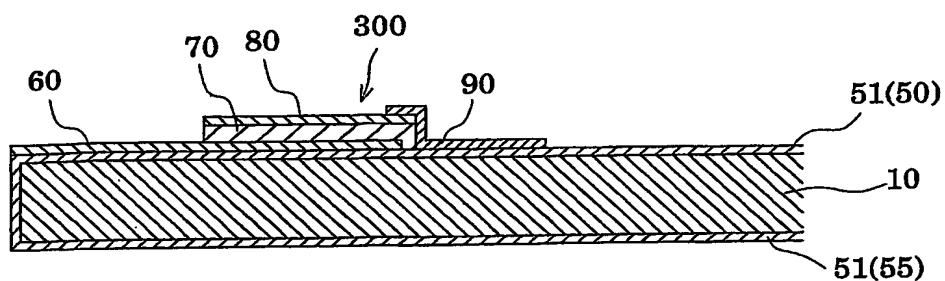


【図 3】

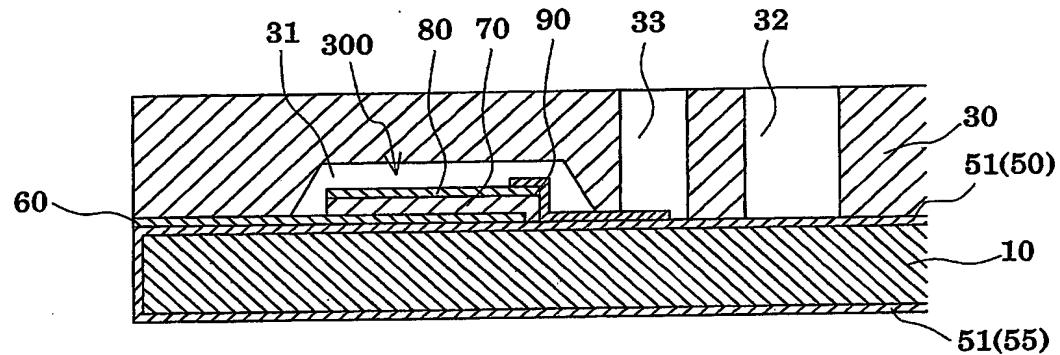


【図4】

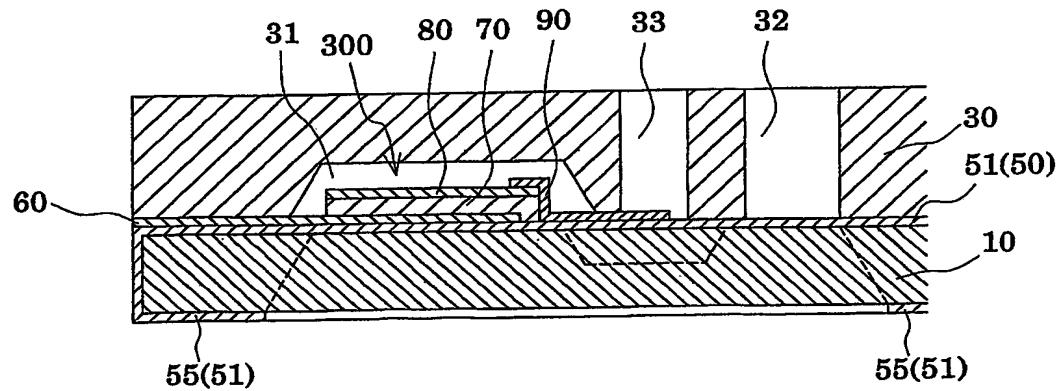
(a)



(b)

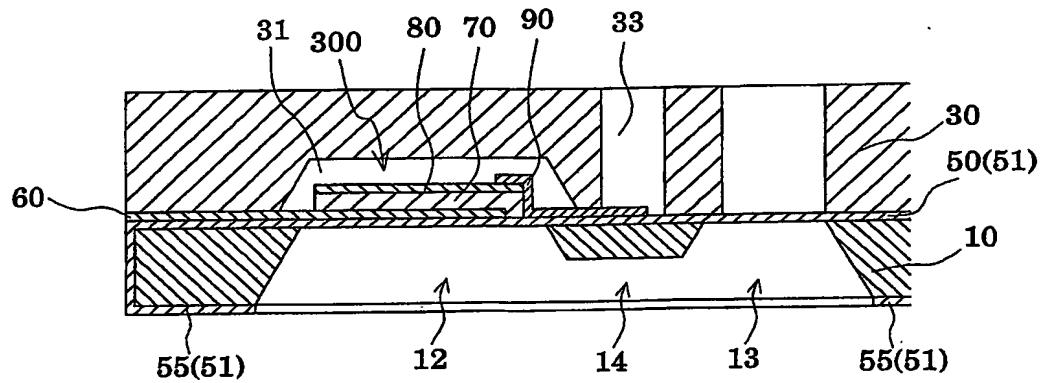


(c)

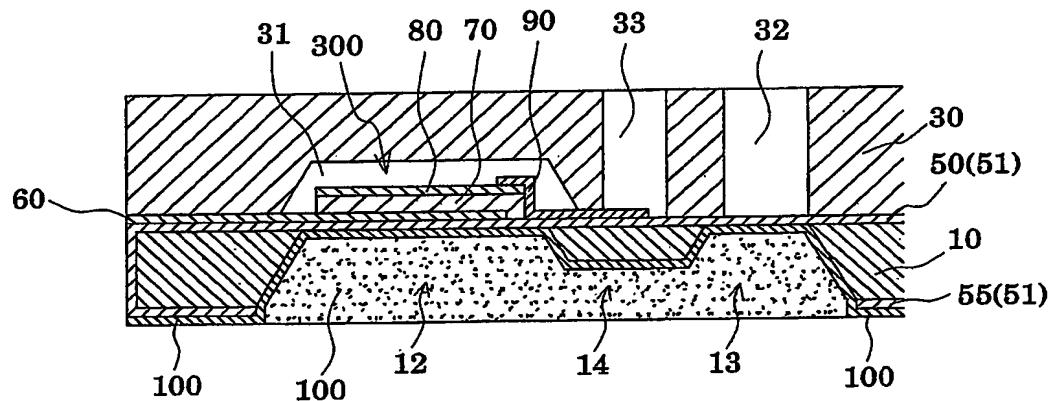


【図5】

(a)

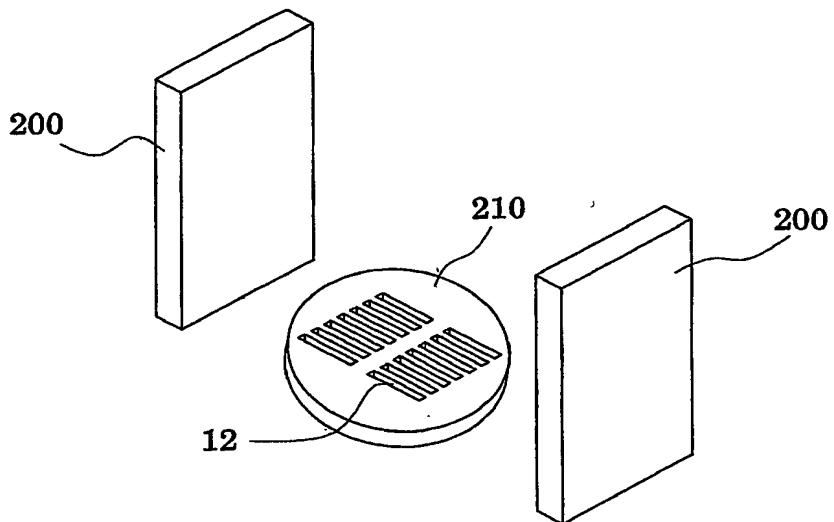


(b)

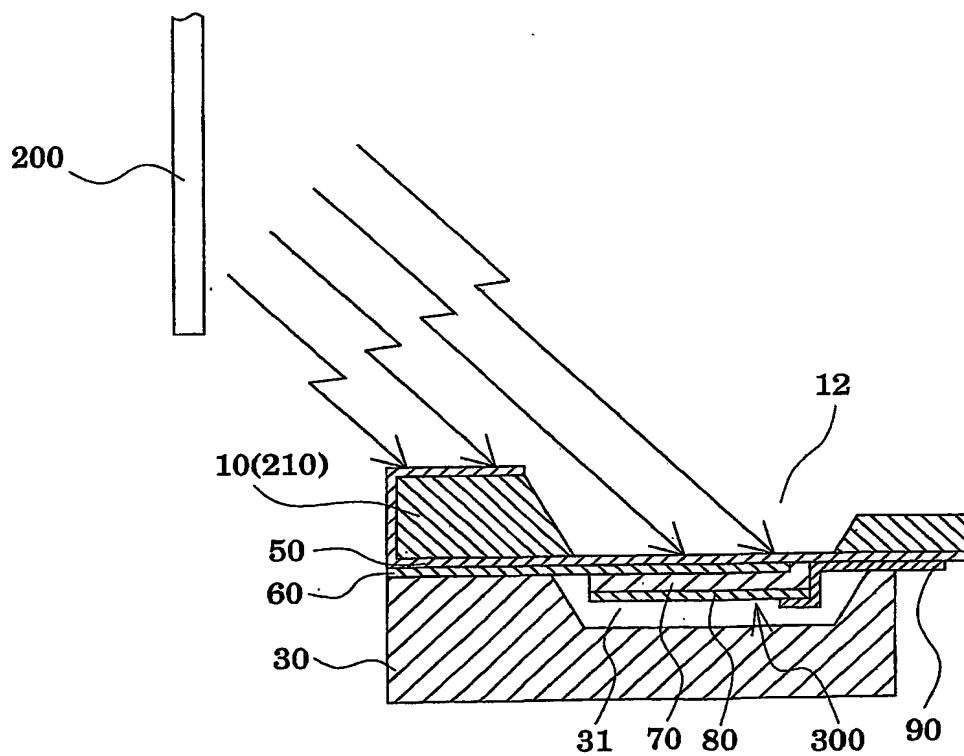


【図6】

(a)

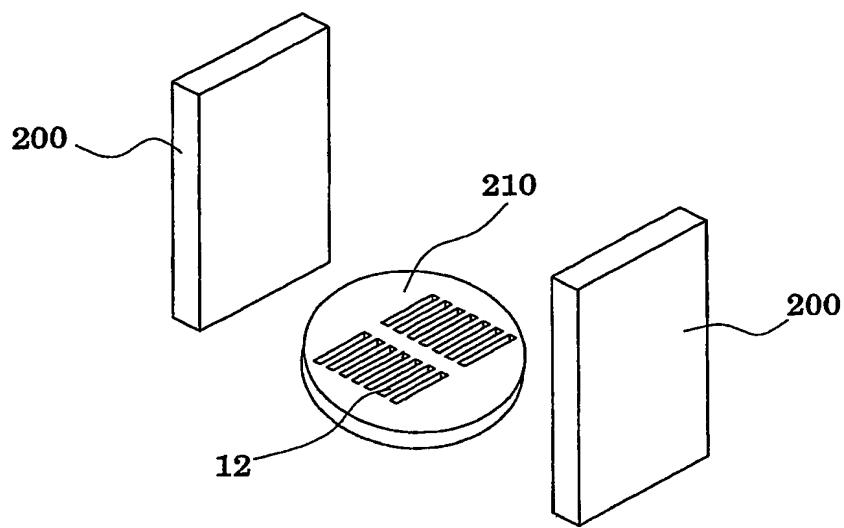


(b)

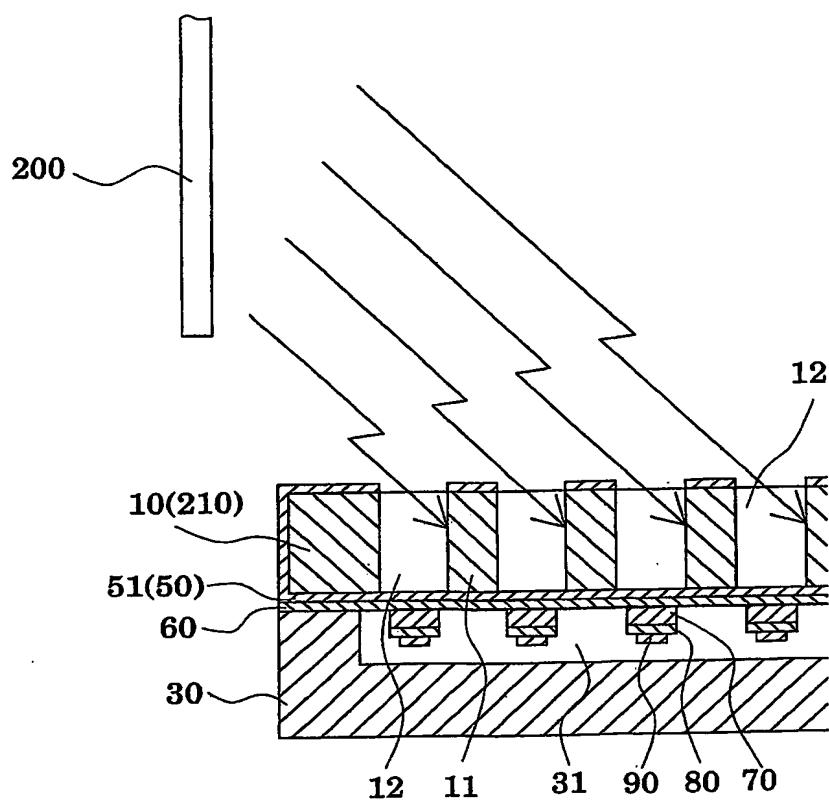


【図7】

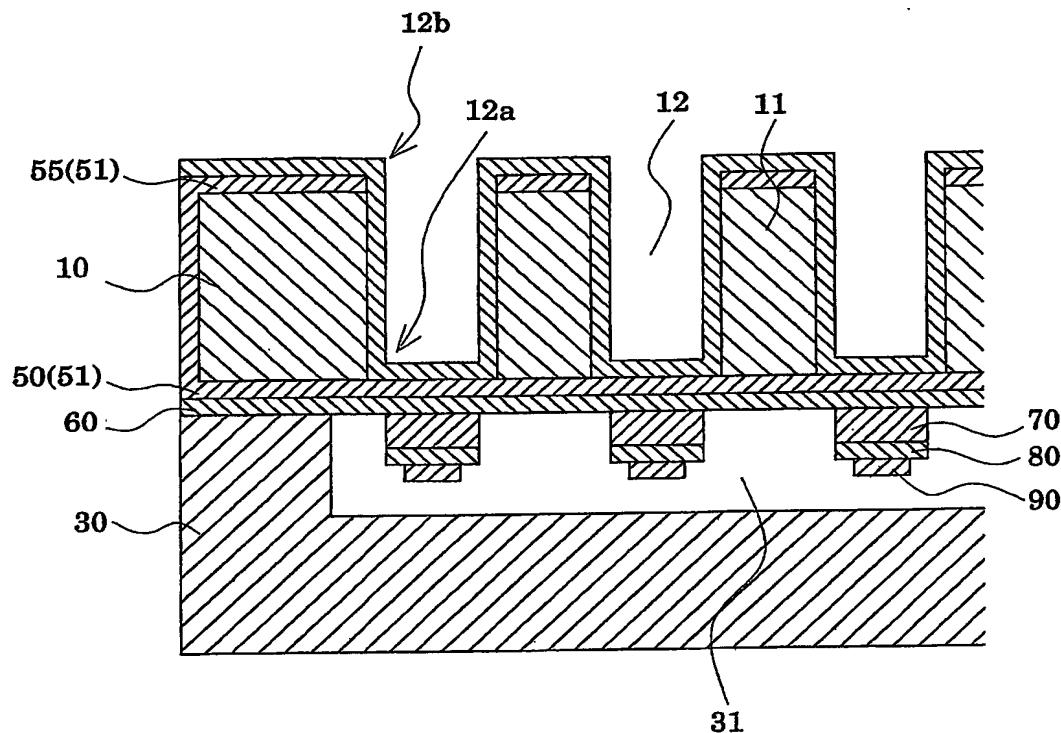
(a)



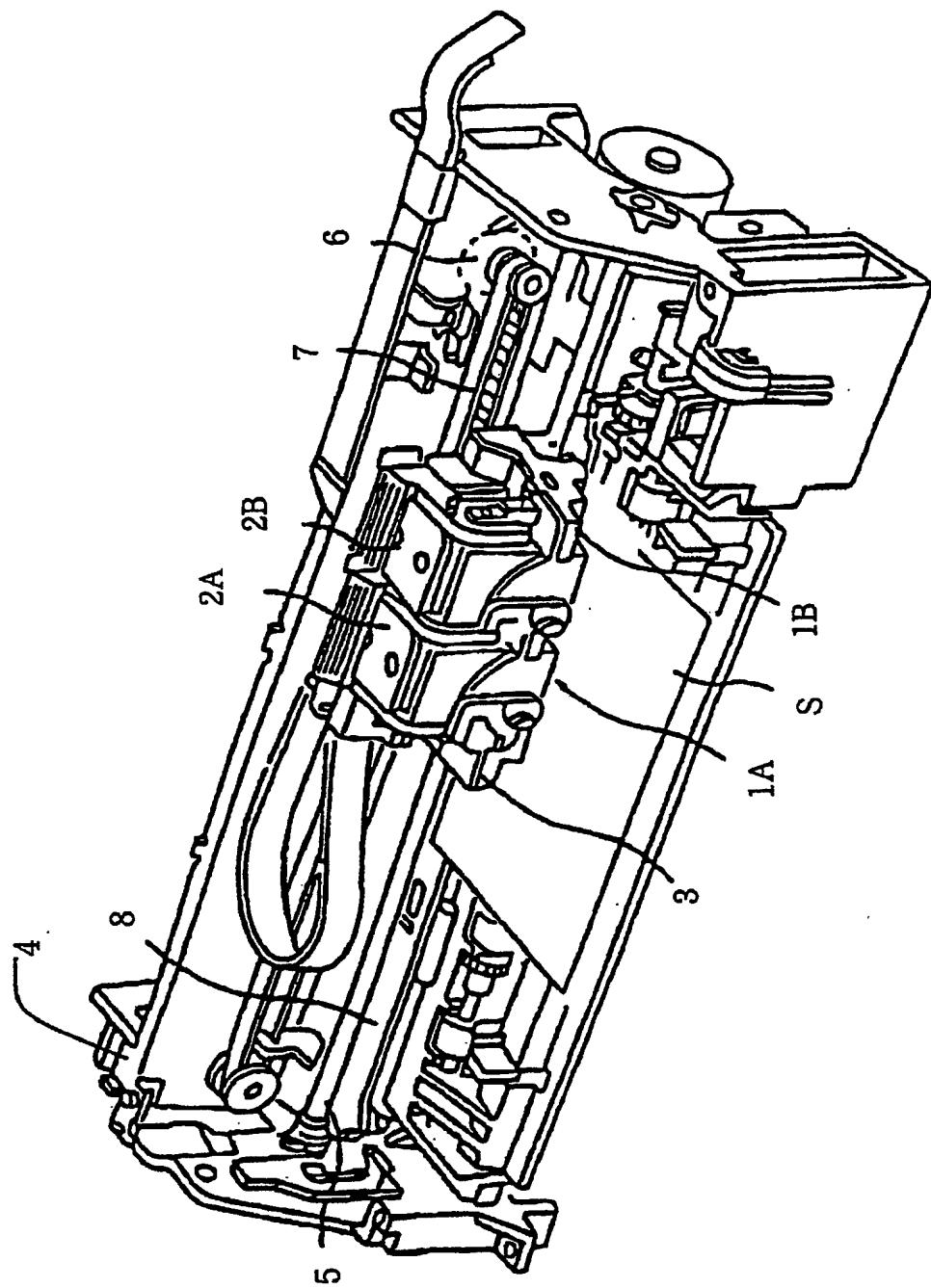
(b)



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 液体吐出特性を長期間一定に維持することができ且つノズル詰まりを防止した液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置を提供する。

【解決手段】 シリコン単結晶基板からなりノズル開口21に連通する圧力発生室12が形成される流路形成基板10と、圧力発生室12内に圧力変化を生じさせる圧力発生素子300とを具備する液体噴射ヘッドにおいて、少なくとも圧力発生室12の内壁表面に酸化タンタルからなる耐液体性の保護膜100を設けることにより、液体吐出特性を長期間一定に維持できると共にノズル詰まりを防止できる。

【選択図】 図2

## 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-001077  
受付番号 50300010546  
書類名 特許願  
担当官 第二担当上席 0091  
作成日 平成15年 1月10日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

【提出日】 平成15年 1月 7日  
【特許出願人】  
【識別番号】 000002369  
【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社  
【代理人】 申請人  
【識別番号】 100101236  
【住所又は居所】 東京都渋谷区恵比寿1丁目5番2号 こうげつビル5階 栗原国際特許事務所  
【氏名又は名称】 栗原 浩之

次頁無

特願2003-001077

出願人履歴情報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
氏名 セイコーエプソン株式会社